

Wolfgang Mildner; MSWtech; DE-Stein

KLEBSTOFFE BEI ANWENDUNGEN MIT VIELEN LAGEN - WIE MAN DIE QUALITÄTSANFORDERUNGEN ERFÜLLT



Gedruckte Elektronik wird heute als Komponente in vielen Produkte verwendet. Insbesondere wenn dies Produkte: dünn, leicht und flexibel oder 3D geformt sein sollen.

Die Anwendungen sind vielfältig von einem integrierten Berührungssensor über ein Display bis hin zu einem Wearable.

Ein gemeinsames Merkmal der Anwendungen ist, dass die Funktionalität durch die Kombination verschiedener Schichten realisiert wird. Die Schichten werden oft mit Klebstoffen verbunden, z. B. durch Laminierung.

Das Erkennen von Qualitätsmängel oder -schwerpunkte insbesondere vor der Freigabe ist eine Herausforderung.

Der Vortrag beschäftigt sich mit Anwendungen, bei denen diese Herausforderungen eine große Rolle spielen. Es werden Beispiele für Systeme gezeigt, die solche Fehler (z.B. Delamination) mit mechanischen, elektrischen und optischen Analysemethoden erkennen.

Ausblick wird die zukünftige Rolle und das Potenzial der künstlichen Intelligenz in der Datenanalyse beleuchtet.